

信頼性試験結果
Reliability Test

XC8111 シリーズ

XC8111 Series

 パッケージ
 Package

SOT-25

RoHS対応品 / RoHS Compliance

ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=6.3V, CE=6.3V		1000	0/22
2	高温逆バイアス High Temperature Reverse Bias	125°C VOUT=6.3V, CE=6.3V		1000	0/22
3	高温保存 High Temperature Storage	150°C		1000	0/22
4	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=6.3V		1000	0/22
5	温度サイクル Temperature Cycle	-65°C~150°C 各30分 30min each		100CYC.	0/22
6	プレッシャークッカーバイアス HAST	130°C85%RH 2×10^5 Pa, VIN=6.3V		100	0/22
7	プレッシャークッカー UHAST	130°C85%RH 2×10^5 Pa		100	0/22
8	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020		-	0/22
9	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM	R=0Ω C=200pF ±200V	3回 3 times	0/5
		HBM	R=1500Ω C=100pF ±1kV	3回 3 times	0/5
		CDM	±500V	3回 3 times	0/5
10	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V		1回 1 time	0/5
		±50mA		1回 1 time	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		試験結果 Result r/n
1	端子引っ張り Terminal Strength	1N 10秒 1N 10s		0/5
2	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 230°C 10s (Temperature profile method)		0/11